



AK-145 高导热非硅质导热膏

特 点

- 为环氧树脂基材的导热膏，非属硅质系统，无渗油问题。
- 高热传导系数 20.0 W/mK。
- 涂抹后不会硬化，易于使用，去除方便，重工性佳。
- 符合 RoHS 2.0 规范。

用 途

- 帮助降低发热组件温度，或是加强导热传热的应用。
- 可应用于 5G、电动汽车、晶体管、温控设备、CPU....等类产品中。

基 本 物 性

外 观 :	灰色膏状物
黏 度 : @25°C	70,000 ~ 110,000 cps
比 重 :	2.4 ~ 2.6 g/cm ³
工 作 温 度 :	110°C
热 传 导 系 数 : Hot Disk ISO22007-2.2	20.0 W/mK
绝 缘 强 度 :	10 kV/mm
体 积 电 阻 :	>10 ¹¹ ohm-cm
热 裂 解 温 度 :	<0.5% (390°C)
U L 阻 燃 等 级 : UL94	V-0 (内部测试)
包 装 :	1KG/罐
保 存 期 限 : @25°C, 未开封	6 个月

注 意 事 项

- 本产品含无机填充物，膏体若发生分层现象属正常情况，须先搅拌均匀后再取用。
- 为免灰尘或杂质影响导热效果，请于上胶前先针对对象表面进行基本清洁后，再进行上胶程序。
- 涂布时，尽可能避免产生气泡，以免影响导热性能。
- 未使用完的产品请保持容器紧闭，并储存于干燥阴凉处且避免阳光直射。
- 主要清洗溶剂为丙酮。



傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976